

LM837

LM837 Low Noise Quad Operational Amplifier



Literature Number: JAJSB7

ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文データシートをご確認ください。



2000年8月

LM837

低ノイズ・クワッド・オペアンプ

概要

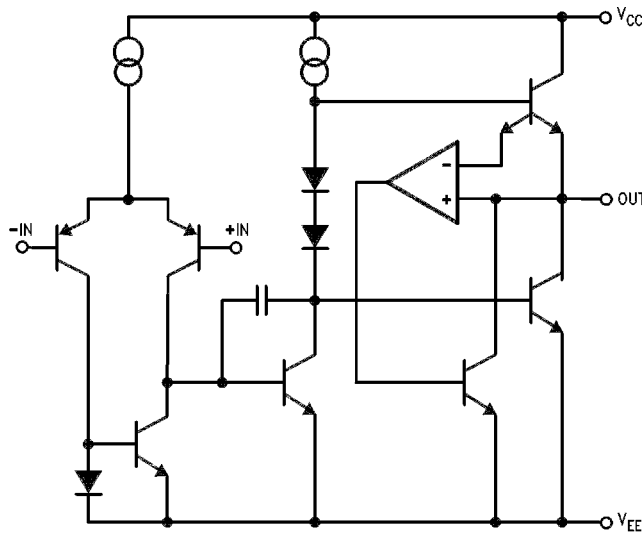
LM837は低ノイズ、高速、および広帯域のクワッド・オペアンプです。LM837は新方式の出力段により、600Ω負荷をドライブできるので、デジタル・オーディオ、グラフィック・イコライザ、プリアンプ、専門的なオーディオ・アプリケーションには理想的です。LM837はまた、その高性能な特徴から、低ノイズが最重要課題である楽器などのアプリケーションに適しています。

LM837は、ユニティー・ゲインでのオペレーションに対して内部補償されています。また、他のほとんどのスタンダード・クワッド・オペアンプとピン・コンパチブルであるため、変更をほとんど加える必要なく、現存するシステムをアップグレードするのに使用することができます。

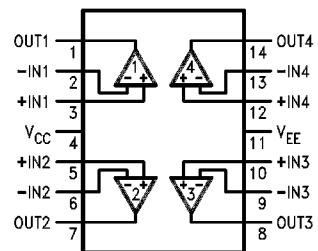
特長

高スレーレート	10 V/μs (代表値); 8 V/μs (最小)
広利得帯域幅積	25 MHz (代表値); 15 MHz (最小)
広パワー帯域幅	200 kHz (代表値)
高出力電流	± 40 mA
出力ドライブ能力	> 600
低入力ノイズ電圧	4.5 nV/√Hz
低全高調波歪率	0.0015%
低オフセット電圧	0.3 mV

等価回路およびピン配置図



Dual-In-Line Package



Top View

Order Number LM837M,
LM837MX or LM837N
See NS Package Number
M14A or N14A

LM837 低ノイズ・クワッド・オペアンプ

絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。

電源電圧 V_{CC}/V_{EE}	$\pm 18V$
差動入力電圧 V_{ID} (Note 2)	$\pm 30V$
同相入力電圧 V_{IC} (Note 2)	$\pm 15V$
消費電力 P_D (Note 3)	1.2W (N) 830 mW (M)
動作温度範囲 T_{OPR}	- 40 ~ + 85
保存温度範囲 T_{STG}	- 60 ~ + 150

ハンダ付け情報

デュアル・インライン・パッケージ
ハンダ付け (10 秒)

260

スモール・アウトライン・パッケージ

ペーパ・フェーズ (60 秒)

215

赤外線 (15 秒)

220

その他の表面実装法については、
アプリケーション・ノート AN-450 「スモール・アウトライン (SO)
パッケージ表面実装と製品信頼性上における効果」を参照下
さい。

DC 電気的特性

 $T_A = 25$ 、 $V_S = \pm 15V$

Symbol	Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Units
V_{OS}	Input Offset Voltage	$R_S = 50$		0.3	5	mV
I_{OS}	Input Offset Current			10	200	nA
I_B	Input Bias Current			500	1000	nA
A_V	Large Signal Voltage Gain	$R_L = 2 k$, $V_{OUT} = \pm 10V$	90	110		dB
V_{OM}	Output Voltage Swing	$R_L = 2 k$	± 12	± 13.5		V
		$R_L = 600$	± 10	± 12.5		V
V_{CM}	Common Mode Input Voltage		± 12	± 14.0		V
CMRR	Common Mode Rejection Ratio	$V_{IN} = \pm 12V$	80	100		dB
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	$V_S = 15 \sim 5$, $-15 \sim -5$	80	100		dB
I_S	Power Supply Current	$R_L =$, Four Amps		10	15	mA

AC 電気的特性

 $T_A = 25$ 、 $V_S = \pm 15V$

Symbol	Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Units
SR	Slew Rate	$R_L = 600$	8	10		V/ μ s
GBW	Gain Bandwidth Product	$f = 100$ kHz, $R_L = 600$	15	25		MHz

設計電気的特性

 $T_A = 25$ 、 $V_S = \pm 15V$ (Note 4)

Symbol	Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Units
PBW	Power Bandwidth	$V_O = 25 V_{P-P}$, $R_L = 600$, THD < 1%		200		kHz
e_{n1}	Equivalent Input Noise Voltage	JIS A, $R_S = 100$		0.5		μ V
e_{n2}	Equivalent Input Noise Voltage	$f = 1$ kHz		4.5		$\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$
i_n	Equivalent Input Noise Current	$f = 1$ kHz		0.7		$\frac{pA}{\sqrt{Hz}}$
THD	Total Harmonic Distortion	$A_V = 1$, $V_{OUT} = 3 V_{rms}$, $f = 20 \sim 20$ kHz, $R_L = 600$		0.0015		%
f_U	Zero Cross Frequency	Open Loop		12		MHz
m	Phase Margin	Open Loop		45		deg
	Input-Referred Crosstalk	$f = 20 \sim 20$ kHz		- 120		dB
V_{OS}/T	Average TC of Input Offset Voltage			2		μ V/

Note 1: 絶対最大定格とは、デバイスが破壊する可能性のあるリミット値を示します。動作条件とはデバイスが機能する条件を示しますが、特定の性能リミット値を保証するものではありません。電気的特性とは、特定の性能リミット値を保証する特別な試験条件での DC および AC の電気的仕様を示します。この場合、デバイスが動作条件の範囲にあるものとします。リミット値 (Limit) が記載されていないパラメータの仕様は保証されませんが、代表値 (Typical) はデバイス性能を示す目安になります。

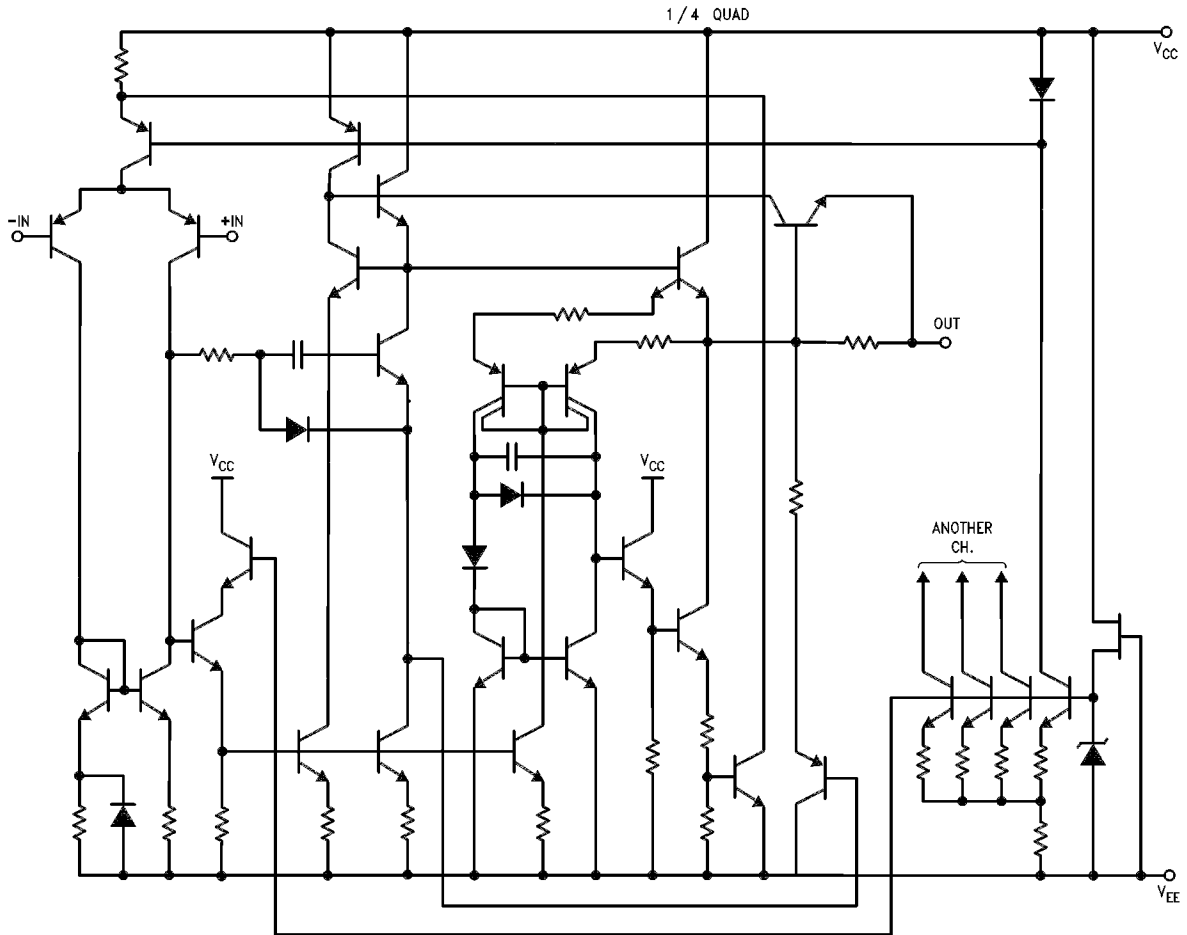
設計電氣的特性 (つづき)

Note 2: 特記のない限り、入力電圧の絶対最大値は電源電圧と同じです。

Note 3: 25 を超える周囲温度で動作させる場合、デバイスは 150 の最大接合部温度とおよび接合部～周囲間の熱抵抗 (LM837N の場合、90 /W、LM837M の場合 150 /W) に基づいて定格を下げなければなりません。

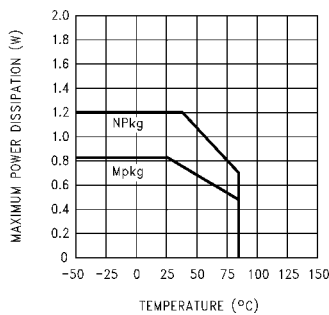
Note 4: 次のパラメータはテストされていないか、あるいは保証されません。

等価回路

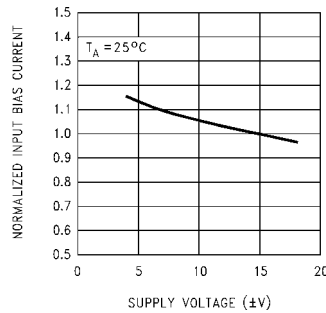


代表的な性能特性

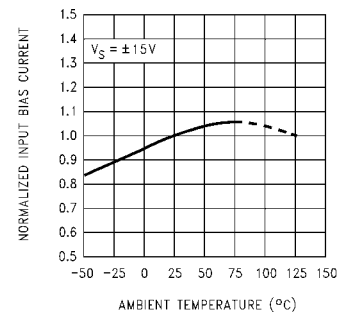
Maximum Power Dissipation vs Ambient Temperature



Normalized Input Bias Current vs Supply Voltage

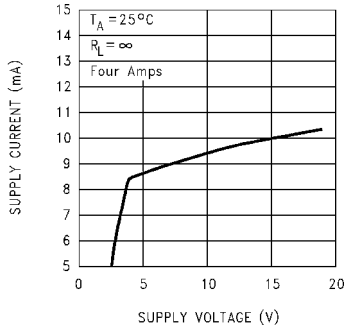


Normalized Input Bias Current vs Ambient Temperature

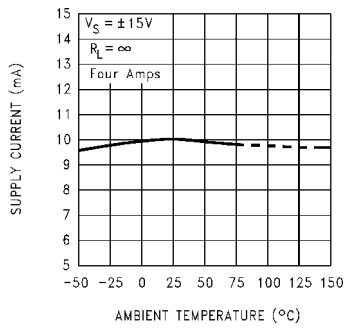


代表的な性能特性 (つづき)

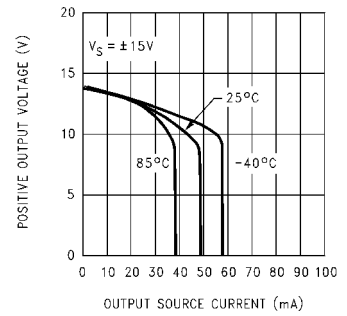
Supply Current vs Supply Voltage



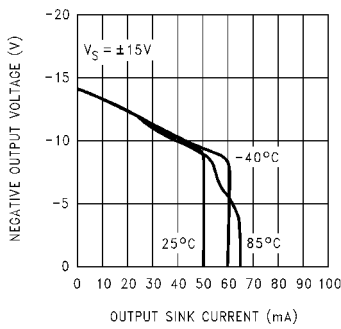
Supply Current vs Ambient Temperature



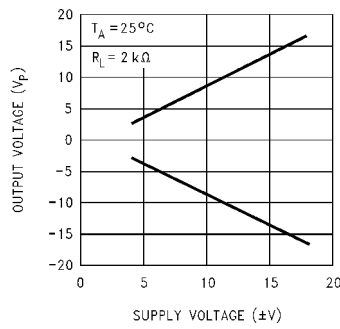
Positive Current Limit



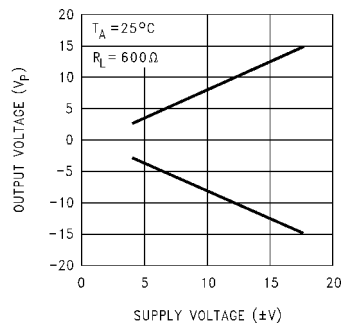
Negative Current Limit



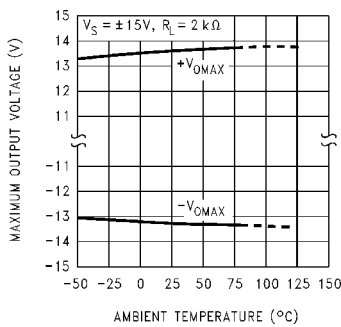
Maximum Output Voltage vs Supply Voltage



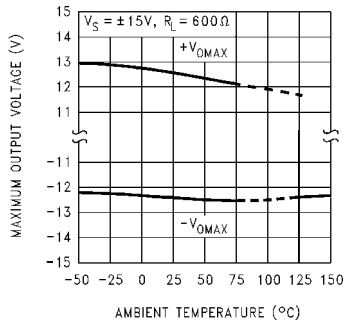
Maximum Output Voltage vs Supply Voltage



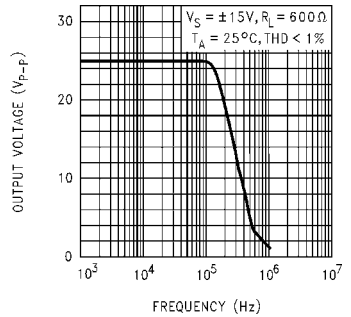
Maximum Output Voltage vs Ambient Temperature



Maximum Output Voltage vs Ambient Temperature

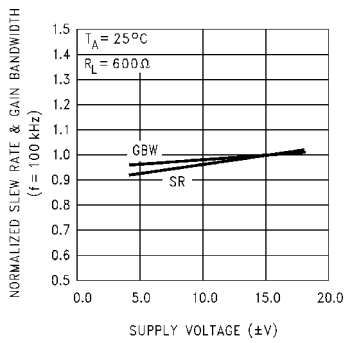


Power Bandwidth

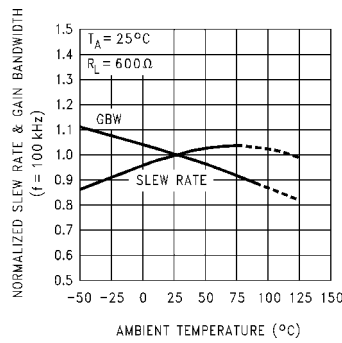


代表的な性能特性 (つづき)

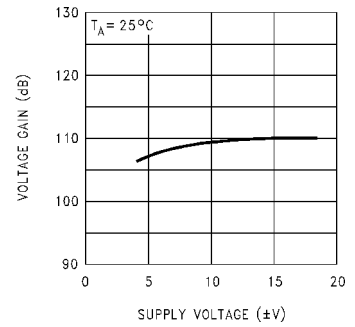
Normalized Slew Rate & Gain Bandwidth vs Supply Voltage (f = 100 kHz)



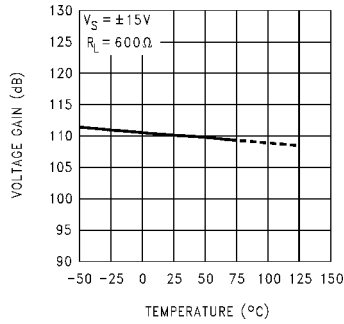
Normalized Slew Rate & Gain Bandwidth (f = 100 kHz) vs Ambient Temperature



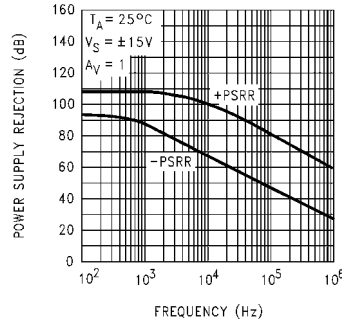
Voltage Gain vs Supply Voltage



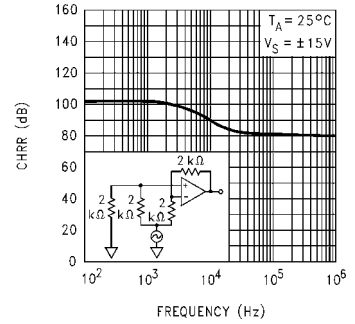
Voltage Gain vs Ambient Temperature



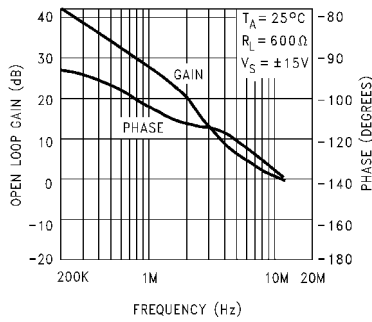
Power Supply Rejection vs Frequency



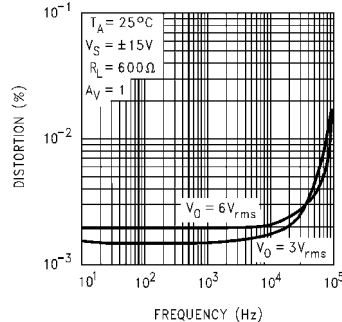
CMRR vs Frequency



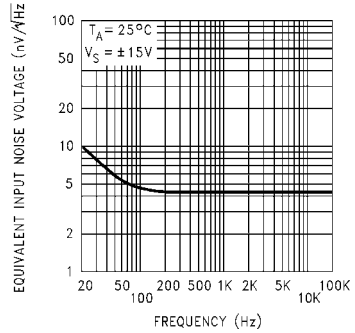
Open Loop Gain & Phase vs Frequency



Total Harmonic Distortion vs Frequency

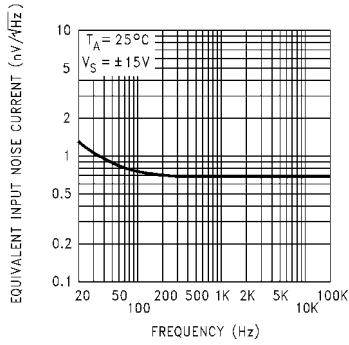


Equivalent Input Noise Voltage vs Frequency



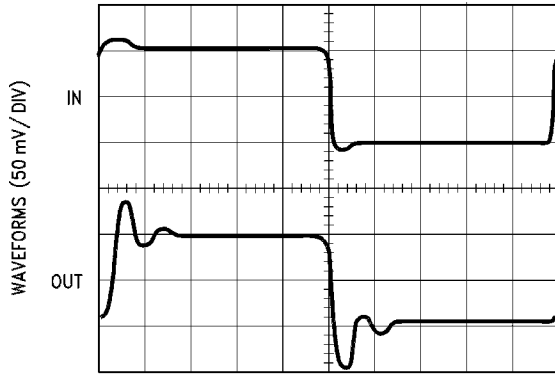
代表的な性能特性 (つづき)

Equivalent Input Noise Current vs Frequency



Small Signal, Non-Inverting

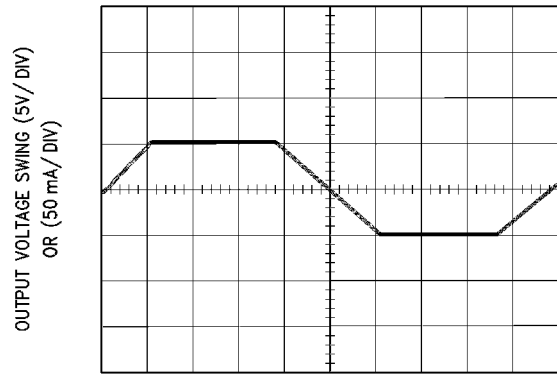
$T_A = 25$, $A_V = 1$, $R_L = 600$, $V_S = \pm 15V$



TIME (0.1 μ s / DIV)

Current Limit

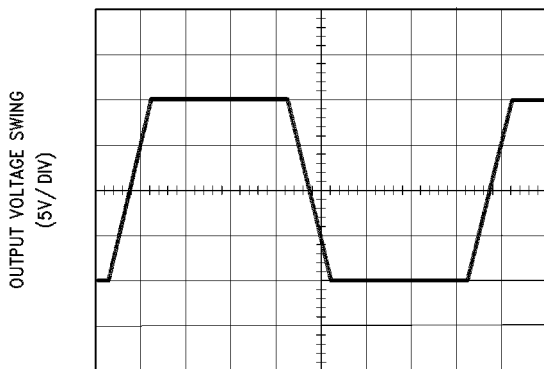
$T_A = 25$, $V_S = \pm 15V$, $R_L = 100$, $A_V = 1$



TIME (0.1 ms / DIV)

Large Signal Non-Inverting

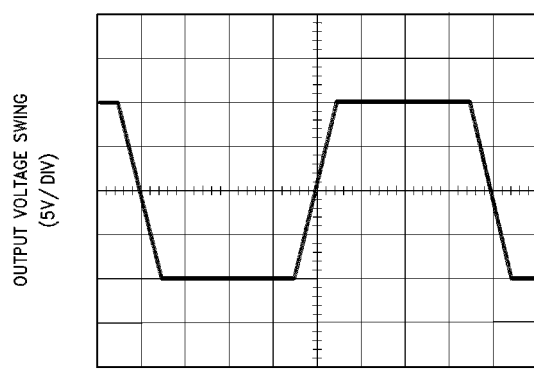
$T_A = 25$, $R_L = 600$, $V_S = \pm 15V$



TIME (1 μ s / DIV)

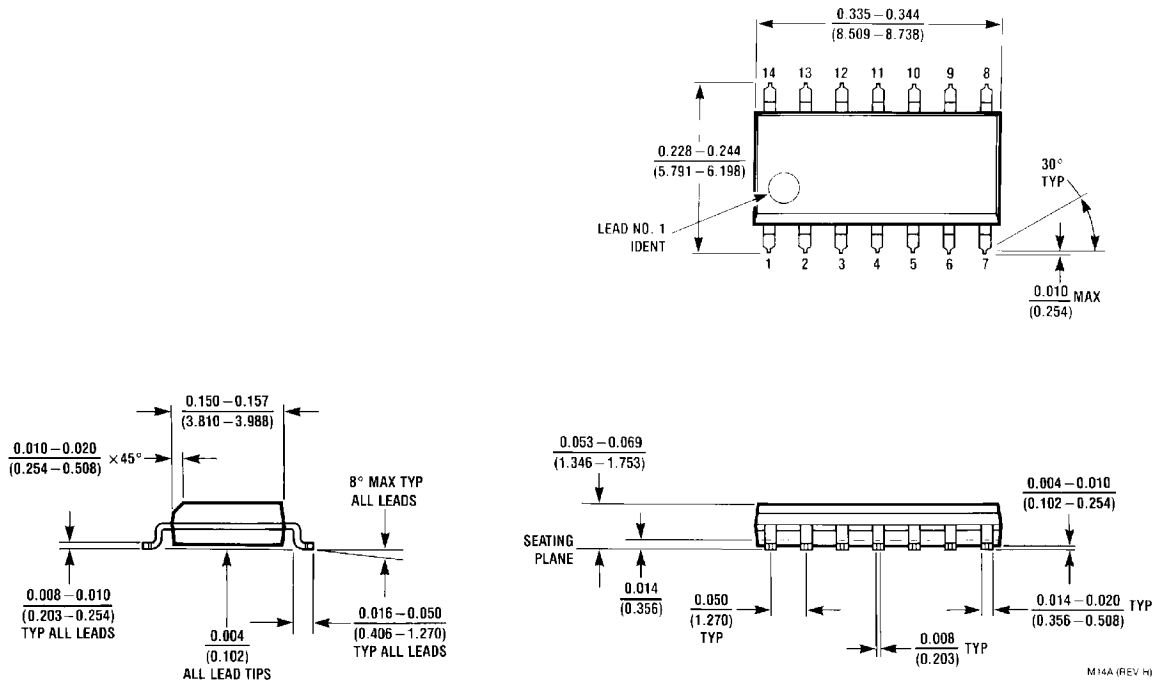
Large Signal Inverting

$T_A = 25$, $R_L = 600$, $V_S = \pm 15V$

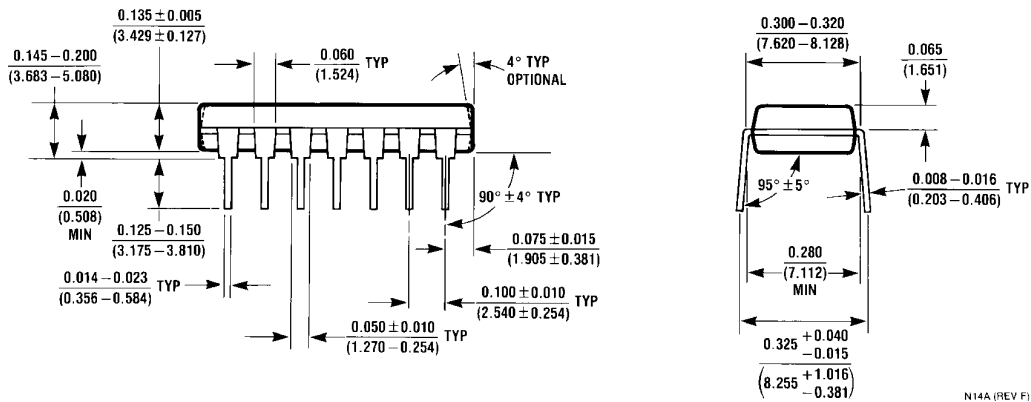
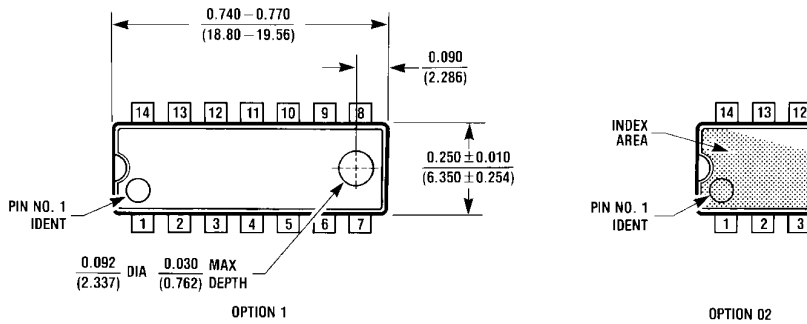


TIME (1 μ s / DIV)

外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)



Molded Package (SO)
Order Number LM837M or LM837MX
NS Package Number M14A



Lit. #107255
Molded Dual-In-Line Package
Order Number LM837N
NS Package Number N14A

生命維持装置への使用について

弊社の製品はナショナル セミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使用することはできません。

1. 生命維持用の装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用方法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。
2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 / 英語）はホームページより入手可能です。

<http://www.national.com/JPN/>

その他のお問い合わせはフリーダイヤルをご利用下さい。



0120-666-116

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えたり、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されてもありません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されてもありません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光が当たる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
 - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
 4. 機械的衝撃
 - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
 5. 熱衝撃
 - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
 6. 汚染
 - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
 - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上